



**SOITEC PRÉSENTE LA GAMME COMPLÈTE  
DE SES TECHNOLOGIES DE SUBSTRATS RF  
AU SALON CS MANTECH, DU 16 AU 19 MAI EN CALIFORNIE**

**Leader en substrats innovants, Soitec est idéalement positionné  
pour équiper les terminaux mobiles connectés de la prochaine décennie**

*Du salon CS ManTech d'Indian Wells, Californie, 16 mai 2011* - Soitec, un leader mondial dans la génération et la production de matériaux semi-conducteurs d'extrêmes performances au cœur des enjeux de l'électronique et de l'énergie, présentera sa gamme complète de substrats à radio-fréquence (RF) pour applications mobiles et grand public, lors de la conférence internationale sur la technologie de fabrication des semi-conducteurs composés (CS ManTech) qui a lieu cette semaine. Soitec est le seul fournisseur de matériaux semi-conducteurs proposant trois technologies de substrats à RF (arséniure de gallium (GaAs-epi), silicium sur isolant avec une base de silicium haute résistivité (Wave SOI™) et silicium sur saphir (B-SoS) pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients en matière d'intégration ou de performance. Ces substrats de Soitec sont tous parfaitement adaptés à la fabrication d'importants volumes de circuits intégrés RF pour les applications mobiles, un segment qui représente en 2011 la moitié du marché électronique grand public.

Les technologies matures de Soitec, telles que Smart Cut™, Smart Stacking™ et épitaxie III-V permettent de réaliser des structures à plusieurs couches, voire plusieurs circuits empilés. Quelle que soit la stratégie de produit poursuivie par les fabricants de circuits RF, Soitec dispose de la technologie de substrat indispensable pour produire des composants aux performances RF supérieures et, à moindre coût.

« Dans des marchés mobile et électronique grand public en constante évolution, nos clients recherchent des solutions matérielles capables d'améliorer l'efficacité et les performances énergétiques, mais également de valoriser l'intégration de leurs produits », déclare Paul Boudre, Directeur général de Soitec. « Notre gamme complète de produits et les technologies associées leur permettent de se démarquer pour atteindre des niveaux de performance plus élevés et se maintenir à la pointe de l'innovation, tout en réduisant leurs coûts et en répondant à la demande du marché ».

Les produits GaAs epi sont une gamme de produits commercialisée par Soitec depuis plusieurs années. Soitec produit ces substrats à grande échelle à l'aide d'une méthode extrêmement précise de croissance de couches minces monocristallines. Le matériau GaAs offrant la mobilité RF la plus élevée, il constitue le substrat de prédilection pour les applications à onde millimétrique. Sa tension de claquage élevée, ses faibles pertes RF et sa grande linéarité en font également le matériau idéal pour la production de circuits intégrés RF à hautes performances. En outre, Soitec déploie son expertise technologique unique pour développer de nouvelles innovations et poursuivre ainsi l'adoption de ce matériau composé sur le marché.

Les autres produits et technologies de Soitec comprennent les substrats Wave SOI™ et Bonded SoS, qui ont les propriétés nécessaires à l'intégration de fonctions digitales et RF incluant les commutateurs d'antenne, les amplificateurs de puissance, les adaptateurs d'antenne sur un même circuit destiné à la production de modules RFFE avancés. Ces modules sont utilisés dans un large éventail d'applications électroniques grand public, des smartphones et tablettes aux consoles de jeux, en passant par les appareils photos numériques.

Les substrats Wave SOI™ de Soitec délivrent des performances exceptionnelles pour l'isolation du signal par rapport au bruit, garantissant ainsi l'intégrité du signal. Ils offrent également un bon niveau de perte d'insertion et une capacité de programmation identique à celle des substrats en silicium brut. Les progrès en cours sur la technologie SOI à base de haute résistivité et sur les options process continuent d'améliorer les performances RF de ce matériau.

Soitec produit également des substrats Bonded SoS grâce à la fois à l'expertise process de la société et les technologies de collage direct afin de transférer et coller une fine couche de silicium de haute qualité sur un substrat en saphir. La couche transférée présente une amélioration impressionnante de la mobilité des porteurs des transistors et une qualité de silicium supérieure aux couches SoS classiques. Les substrats de Soitec améliorent les performances et la fonctionnalité des circuits intégrés RF tout en réduisant leurs dimensions, dans des proportions pouvant atteindre jusqu'à 30 %.

Soitec occupera le stand N° 502 au salon professionnel CS ManTech qui aura lieu du 16 au 19 mai à Indian Wells, en Californie. A titre d'information complémentaire, un nouveau « livre blanc » consacré aux technologies de substrats RF pour les communications mobiles est disponible sur le site Web de Soitec, à l'adresse suivante : [www.soitec.com](http://www.soitec.com).

### **À propos de Soitec**

[Soitec](http://www.soitec.com) est une entreprise industrielle internationale dont le cœur de métier est la génération et la production de matériaux semi-conducteurs d'extrêmes performances. Ses produits, des substrats pour circuits intégrés (notamment à base de SOI - Silicium On Insulator) et des systèmes photovoltaïques à concentration (CPV), ses technologies Smart Cut™, Smart Stacking™ et Concentrix™ ainsi que son expertise en épitaxie en font un leader mondial. Soitec relève les défis de performance et d'efficacité énergétique pour une large palette d'applications destinées aux marchés de l'informatique, des télécommunications, de l'électronique automobile, de l'éclairage et des centrales solaires à forte capacité. Soitec a aujourd'hui des implantations industrielles et des centres de R&D en France, à Singapour, en Allemagne et aux Etats-Unis.

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet [www.soitec.com](http://www.soitec.com).

#### **Contact Presse française**

Marie-Caroline Saro, H&B Communication  
+33 (0)1 58 18 32 44  
mc.saro@hbcommunication.fr

#### **Contact Presse internationale**

Camille Darnaud-Dufour  
+33 (0)6 79 49 51 43  
camille.darnaud-dufour@soitec.com

# # #